

通富微电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放等基本情况

(一) 2015年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2015)370号文核准,并经深圳证券交易所同意,通富微电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)98,310,291股,发行价格为每股13.02元,募集资金总额为128,000万元,扣除承销费和保荐费2,716万元后的募集资金为125,284万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年4月17日汇入公司中国银行南通分行491066628196账号内,在扣减审计费、律师费、法定信息披露费、前期预付保荐费等其他发行费用224.83万元后,本次募集资金净额为125,059.17万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2015)第110ZA0161号验资报告验证。

截至2019年12月31日,2015年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存储余额	备注
中国银行股份有限公司南通分行	491066628196	--	已销户
中国工商银行南通分行营业部	1111822229100525370	--	已销户
合计		--	

(二) 2017年非公开发行股份购买资产

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2008号《关于核准通富微电子股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准本公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“产业基金”)发行181,074,458股股份购买其所持有的南通富润达投资有限公司(以下简称“富润达”)49.48%股权、南通通润达投资有限公司(以下简称“通润达”)47.63%股权,发行价格为每股10.61元。本次发行未募集配套资金。

上述非公开发行股份购买资产情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第110ZA0451号验资报告验证。

截至2019年12月31日，2017年非公开发行股份购买资产已完成。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）2015年非公开发行股票

1、2015年非公开发行股票募集资金的实际使用情况

见“附件1 2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、2015年非公开发行股票募集资金项目的实际投资额与承诺差异的说明

单位：万元

序号	承诺投资项目	承诺募集资金投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
1	移动智能通讯及射频等集成电路封装测试项目	79,000.00	79,099.14	99.14	注1
2	智能电源芯片封装测试项目	34,000.00	-	-34,000.00	注2
3	永久补充流动资金	12,059.17	13,629.70	1,570.53	注3
4	收购 Advanced Micro Devices, Inc.（以下简称 AMD）子公司股权项目	-	35,029.61	35,029.61	注4
合计		125,059.17	127,758.45	2,699.28	

注1：实际投资金额包含募集资金产生的理财收益投入 99.14 万元。

注2：募投项目变更情况见“三、前次募集资金实际投资项目变更情况”。

注3：实际投资金额包含募集资金产生的理财收益和专户存储累计利息扣除手续费净收入 1,570.53 万元。

注4：实际投资金额包含募集资金产生的理财收益和专户存储累计利息扣除手续费净收入 1,029.61 万元。

（二）2017年非公开发行股份购买资产

产业基金持有的富润达 49.48%股权、通润达 47.63%的股权受让至本公司的股东变更工商变更登记手续或其他有权部门登记手续已办理完成。

富润达已取得南通市经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码: 91320691MA1MCG1H39), 通润达已取得南通市经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码: 91320691MA1M9A603H)。

2018年1月3日, 本公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人业务部于2018年1月8日出具的《股份登记申请受理确认书》(业务单号: 101000006182), 本次非公开发行新股数量为181,074,458股, 相关股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册。

本次非公开发行股票已全部用于购买产业基金持有的富润达49.48%股权、通润达47.63%股权。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

(一) 2015年非公开发行股票

由于市场原因, PDFN系列集成电路封装测试产品需求增长低于预期, “智能电源芯片封装测试项目”如按原计划投入, 很难达到预期目标。2016年3月23日, 本公司召开第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》。同时, 监事会发表了明确同意的意见; 独立董事发表了明确同意的独立意见; 招商证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。

2016年4月11日, 公司召开2016年第二次临时股东大会审议并决议终止“智能电源芯片封装测试项目”, 并将相关募集资金用途变更为“南通富润达投资有限公司增资暨收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权项目”, 即将募集资金用于收购AMD间接持有的超威半导体技术(中国)有限公司(以下简称“AMD苏州”)及Advanced Micro Devices Export SDN.BHD(以下简称“AMD槟城”)各85%的股权。

(二) 2017年非公开发行股份购买资产

2017年非公开发行股份购买资产项目因未实际进行配套融资, 故承诺募投项目不涉及变更事项。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

2、2015年非公开发行股票投资项目置换情况

根据公司非公开发行股票预案，截至2015年6月23日，本公司已以自筹资金预先投入到募集资金投资项目“移动智能通讯及射频等集成电路封装测试项目”17,810.92万元。公司从募集资金专户中转出17,810.92万元用于置换先期投入的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目预先投入情况进行了专项审核，并出具了致同专字（2015）第110ZA2896号《关于南通富士通微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

五、临时闲置募集资金情况

（一）闲置募集资金购买银行理财产品情况

1、为提高募集资金使用效率以及降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，经本公司2015年4月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在本次非公开发行新增股份上市后至2016年4月27日、累计不超过11亿元的最高额度内，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行保本型理财产品。

2、为了提高暂时闲置募集资金的存放效益、合理降低财务费用，经本公司2015年5月11日第五届董事会第五次会议、2015年5月29日2015年第一次临时股东大会通过的《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》，本公司使用临时闲置募集资金购买保本型理财产品，最高额度不超过9.3亿元（含本数）。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

3、为了提高暂时闲置募集资金的存放效益、合理降低财务费用，经本公司2016年3月30日第五届董事会第十五次会议、2016年4月22日2015年度股东大会通过的《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，本公司自2016年5月29日起一年内，使用最高额度不超过人民币2.5亿元（含本数）临时闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

根据上述决议，本公司使用闲置募集资金现金管理、投资理财产品累计金额44.20亿元，每笔理财产品到期后均及时收回资金，截至2016年3月31日公司已全部收回募集资金，之后再未发生临时使用闲置募集资金购买理财产品的情形。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

六、尚未使用募集资金情况

本公司前次募集资金已全部使用完毕。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

见“附件 2 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

2、前次募集资金投资项目未承诺效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目中，2015 年非公开发行股票募集资金用于“收购 AMD 子公司股权”项目，因系用于收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85% 股权，未承诺效益。

前次募集资金投资项目中，2017 年非公开发行股份用于收购富润达 49.48% 股权、通润达 47.63% 的股权，该次非公开发行未配套募集资金，未承诺效益。

2015 年非公开发行股票募集资金用于“收购 AMD 子公司股权”项目和 2017 年非公开发行股份用于收购富润达 49.48% 股权、通润达 47.63% 的股权对应的资产最终均为苏州通富超威半导体有限公司（以下简称“通富超威苏州”）、TF AMD MICRO ELECTRONICS(PENANG) SDN.BHD（以下简称“通富超威槟城”）的股权，两家公司在先进封装领域具有较强的技术优势，经过多年的发展积累，形成了以倒装封装为主的技术线路，主要量产技术包括 FCBGA、FCPGA、FCLGA、MCM，其主要从事 CPU、GPU、APU、游戏机芯片等高端产品的封装测试。收购后，公司获得了 FCBGA 等高端封装技术和大规模量产能力。同时，使得公司更有能力支持国产 CPU、GPU、网关服务器、基站处理器、FPGA（现场可编程门阵列）等产品的研发和量产。通过收购，公司与 AMD 形成了“合资+合作”的强强联合模式，进一步增强了公司在客户群体上的优势。

通富超威苏州、通富超威槟城实际经营情况见下文“八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况”。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

（一）2015 年非公开发行股票

1、资产权属变更情况

为完成收购 AMD 子公司股权，本公司在境内分别于 2015 年 10 月 10 日和 12 月 8 日投资设立了全资子公司通润达和富润达（其后通过将通润达 100% 股权转让给富

润达的方式间接持有通润达 100%的股权)。

产业基金作为战略投资者，通过与本公司签署《共同投资协议》，约定向通润达和富润达增资，增资完成后，本公司和产业基金分别持有富润达 50.52%和 49.48%的股权，富润达和产业基金分别持有通润达 52.37%和 47.63%的股权。

上述股权调整完成后，通润达作为收购 AMD 苏州股权的主体；2015 年 11 月 17 日，通润达在香港投资设立全资子公司钜天投资，作为收购 AMD 槟城股权的主体。

(1) 通富超威苏州股权变更情况

2016 年 4 月 11 日，AMD 中国和通润达签署《股权转让协议》，AMD 中国将其拥有的 AMD 苏州 85%的股权受让予通润达。2016 年 4 月 11 日，AMD 苏州的股东签署《超威半导体技术（中国）有限公司修改及重述后的公司章程》，对相关条款作出相应修改。2016 年 4 月 11 日，AMD 中国和通润达签署《合资合同》。2016 年 4 月 14 日，苏州工业园区管委会下发《园区管委会关于超威半导体技术（中国）有限公司股权转让的批复》（苏园管复部委资审[2016]27 号），同意 AMD 中国将其持有的 AMD 苏州 85%的股权及相应的权利义务、债权债务转让予通润达；同意 AMD 苏州性质由外商独资变更为中外合资。2016 年 4 月 14 日，江苏省人民政府向 AMD 苏州换发《外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2016]49789 号），企业类型变更为“中外合资企业（外资比例小于 25%）”，投资者变更为 AMD 中国和通润达。2016 年 4 月 26 日，苏州工业园区工商行政管理局向 AMD 苏州换发《营业执照》（统一社会信用代码：91320594759661883L）。

2016 年 5 月 23 日，江苏省人民政府向 AMD 苏州换发《外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2016]49789 号），“超威半导体技术（中国）有限公司”名称变更为“苏州通富超威半导体有限公司”。2016 年 5 月 23 日，苏州工业园区工商行政管理局向 AMD 苏州换发《营业执照》（统一社会信用代码：91320594759661883L），对企业名称作出相应变更。

(2) 通富超威槟城股权变更情况

2016 年 4 月 29 日，AMD 马来西亚将其持有的 AMD 槟城每股价值 1 马来西亚林吉特的共 1,334,500 股普通股转让予钜天投资。2016 年 7 月，“ADVANCED MICRO DEVICES EXPORT SDN. BERHAD”名称变更为“TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.”。

2、资产账面价值变化情况

(1) 通富超威苏州收购前后账面价值变化情况如下（单元：万元）：

项目	2016/4/29 (交割日)	2016/12/31	2017/12/31	2018/12/31	2019/12/31
资产总额	130,186.46	142,678.02	172,239.79	209,949.11	262,321.68
负债总额	19,674.90	28,517.48	53,728.47	80,805.07	120,853.01
净资产	110,511.56	114,160.54	118,511.32	129,144.04	141,468.67

(2) 通富超威槟城收购前后账面价值变化情况如下(单位: 万元):

项目	2016/4/29 (交割日)	2016/12/31	2017/12/31	2018/12/31	2019/12/31
资产总额	91,872.58	110,586.67	122,490.66	137,608.55	190,490.59
负债总额	23,246.73	37,719.57	38,246.23	40,233.93	85,986.88
净资产	68,625.85	72,867.10	84,244.43	97,374.62	104,503.71

3、生产经营情况

收购完成后, 本公司绑定优质客户 AMD; 同时, 本公司充分利用通富超威苏州、通富超威槟城两个高端 CPU、GPU 量产封测平台, 积极承接国内外客户高端 CPU、GPU 的封测业务, 与博通、三星、ZTE、IDT、NXP 以及中国国产 CPU 芯片公司的业务合作进展顺利。完成股权交割以来, 本公司运营管理正常, 通富超威苏州、通富超威槟城整合推进有序。通富超威苏州、通富超威槟城积极应对 AMD 订单, 多项新产品成功量产, 同时导入多家知名新客户; 通富超威槟城新厂房完成工程建设, 并投入使用, 成功导入 WLCSP 产品。

截至 2019 年 12 月 31 日, 通富超威苏州、通富超威槟城各项业务生产经营正常。

4、效益贡献情况

单位: 万元

项目	年度	2016 年度		2017 年度		2018 年度		2019 年度	
		金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
通富超威苏州	收入	64,716.71	125,961.03	94.63%	164,833.70	30.86%	224,985.70	36.49%	
	净利润	3,648.99	4,350.77	19.23%	10,632.72	144.39%	12,324.63	15.91%	
通富超威槟城	收入	109,277.58	169,574.09	55.18%	159,813.85	-5.76%	207,956.29	30.12%	
	净利润	10,297.53	8,661.30	-15.89%	10,936.34	26.27%	4,050.56	-62.96%	
合计	收入	173,994.29	295,535.12	69.85%	324,647.55	9.85%	432,941.99	33.36%	
	净利润	13,946.52	13,012.07	-6.70%	21,569.06	65.76%	16,375.19	-24.08%	

5、承诺事项履行情况

(1) 业绩承诺履行情况

收购 AMD 苏州、AMD 槟城股权项目中的交易对方 AMD 中国和 AMD 马来西亚未作业绩承诺。交易对方与通富超威苏州、通富超威槟城于 2016 年 4 月 29 日分别签署《协议书》(或称《利润目标协议》), 协议约定: AMD 同意其承诺支持通富超威苏州及通富超威槟城达成其中双方均可接受的、已经达成一致的预期目标, 包括收入和利润目标(“利润”是指按美国通用会计准则计算、与 AMD 相关的息税前利润), 利润目标为: 自生效日起 36 个月内, 每个财政年度通富超威苏州及通富超威槟城合计共 2,000 万美元。《利润目标协议》的内容系本公司与 AMD 在合理商业谈判的基础上所做出的切实可行的商业安排, 未就利润目标未达成时的补偿措施进行约定。

2016 年 4 月 29 日通富超威苏州、通富超威槟城股权的资产交割及过户完成后, AMD 增加了对通富超威苏州及通富超威槟城的订单量, 并加快了新产品的导入速度。除交割日后首个财政年度内, 为使通富超威苏州及通富超威槟城达成 2,000 万美元的利润目标, AMD 支付补偿款合计人民币 1,357.04 万元外, 在其后的第二、第三个财政年度, AMD 通过增加对通富超威苏州及通富超威槟城业务订单的方式, 均使两家公司实现了合计 2,000 万美元的利润目标值。

(2) 过渡期损益安排

本次收购不存在过渡期损益安排。

(3) 其他承诺履行情况

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺履行情况
规范关联交易的承诺函	AMD	承诺人与通富微电、AMD 苏州、AMD 槟城之间的关联交易, 将在所有重大方面遵循市场公正、公平、公开的原则, 并依法签订协议, 履行所适用的合法程序。本承诺自承诺人持有 AMD 苏州、AMD 槟城股份期间不可撤销。	正常履行
避免资金占用的承诺函	AMD	本次交易完成后, AMD 以及其所控制的其他企业将尽商业合理努力预防和杜绝 AMD 苏州以及 AMD 槟城的非经营性占用资金情况发生, 不违规使用 AMD 苏州以及 AMD 槟城的资金及其他资产、资源, 不以直接或间接	正常履行

		方式从事损害通富微电、AMD 苏州及 AMD 槟城及其股东利益的行为。	
--	--	-------------------------------------	--

(二) 2017 年非公开发行股份购买资产

1、资产权属变更情况

见上文“二、前次募集资金的实际使用情况”之“(二) 2017 年非公开发行股份购买资产”部分。

2、资产账面价值变化、生产经营、效益贡献等情况

由于富润达、通润达是公司设立的对通富超威苏州、通富超威槟城投资的持股平台，无其他经营业务，相关资产账面价值变化、生产经营、效益贡献等情况，见上文“八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况”之“2015 年非公开发行股票”部分。

3、承诺事项履行情况

(1) 业绩承诺履行情况

2017 年非公开发行股份购买资产不存在业绩承诺情况。

(2) 过渡期损益安排

根据本公司与产业基金分别于 2015 年 12 月 25 日、2016 年 1 月 18 日、2016 年 10 月 18 日签署的《南通富士通微电子股份有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司之共同投资协议》、《南通富士通微电子股份有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司之售股权协议》及《南通富士通微电子股份有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司之发行股份购买资产协议》，自评估基准日（不含评估基准日当日）起至股权交割日一个月最后一日止的期间为过渡期。经各方同意，标的公司在过渡期间产生的收益由本公司享有，标的公司在过渡期间产生的亏损由本公司与产业基金根据本次交易前其在富润达、通润达的持股比例承担，并于本次交易完成后产业基金以现金形式对本公司予以补偿。

该项交易的过渡期为自评估基准日（即 2016 年 6 月 30 日）至交割日（以资产过户工商登记之日为准）期间。标的资产过户工商登记完成时间为 2017 年 12 月 13 日，因此过渡期确定为 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同专字（2018）第 110ZA4679 号”《南通通润达投资有限公司 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日过渡期损益审

计报告》，通润达 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日合并利润表归属于母公司净利润为 102,315,204.90 元。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“致同专字(2018)第 110ZA4600 号”《南通富润达投资有限公司 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日过渡期损益审计报告》，富润达 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日合并利润表归属于母公司净利润为 53,581,290.77 元。

(3) 其他承诺履行情况

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺履行情况
股份锁定承诺	产业基金	如本公司通过本次重组获得上市公司的新增股份时，持有的标的资产未满 12 个月，该等股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。如本公司通过本次重组获得上市公司新增股份时，持有的标的资产已满 12 个月，该等股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。	正常履行
减少和规范关联交易的承诺	产业基金	在本次重组完成后，本公司及本公司控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《通富微电子股份有限公司章程》等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本公司将对前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。	正常履行
资产权属	本公司	一、截至本承诺函签署日，本公司依法持有富润达 49.48%的股权和通润达 47.63%的股权，对于本公司所持该等股权，本公司确认，本公	正常履行

		<p>司已经依法履行对富润达和通润达的出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响富润达和通润达合法存续的情况。</p> <p>二、本公司持有的富润达和通润达的股权均为实际合法拥有,不存在权属纠纷,不存在信托、委托持股或者类似安排,本公司所持富润达和通润达股权不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制。本公司若违反上述承诺,将承担因此给上市公司造成的一切损失。</p>	
--	--	--	--

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照,不存在不一致情形。

附件: 1、2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

通富微电子股份有限公司董事会

2020年4月10日

附件 1:

2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			125,059.17			已累计使用募集资金总额			127,758.45	
募集资金变更用途情况						其中：各年度使用募集资金金额				
其中：变更用途的募集资金总额			34,000.00			2015 年度			50,602.85	
						2016 年度			71,855.29	
						2017 年度			3,729.78	
变更用途的募集资金总额比例			27.19%			2018 年度			1,570.53	
						2019 年度			--	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	移动智能通讯及射频等集成电路封装测试项目	移动智能通讯及射频等集成电路封装测试项目	79,000.00	79,000.00	79,099.14	79,000.00	79,000.00	79,099.14	99.14	2017 年 9 月 30 日
2	智能电源芯片封装测试项目	收购 AMD 子公司股权项目	34,000.00	34,000.00	35,029.61	34,000.00	34,000.00	35,029.61	1,029.61	2016 年 4 月 29 日
3	永久补充流动资金	永久补充流动资金	15,000.00	12,059.17	13,629.70	15,000.00	12,059.17	13,629.70	1,570.53	
合计			128,000.00	125,059.17	127,758.45	128,000.00	125,059.17	127,758.45	2,699.28	

说明：截至期末累计投入金额 127,758.45 万元，包括以募集资金产生的利息和理财收益投入 2,699.28 万元。

公司法定代表人：石明达

主管会计工作的公司负责人：朱红超

公司会计机构负责人：张荣辉

附件 2:

2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率 (注 1)	承诺效益(注 2)	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益 (注 3)
序号	项目名称			2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	移动智能通讯及射频等集成电路封装测试项目	102.55%	9,855.55	4,271.47	7,983.30	5,677.72	3,959.24	21,891.73	否
2	收购 AMD 子公司股权项目	不适用							
3	永久补充流动资金	不适用							

注 1: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2: 系《2015 年度非公开发行股票预案》相关效益分析测算的募投项目达产当年新增净利润, 实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益一致。

注 3: 是否达到预计效益是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 累计效益与承诺效益的对比。项目自 2017 年 9 月 30 日达到预计可使用状态, 2017 年 10 月-2019 年 12 月累计效益 11,293 万元, 承诺效益 9,855.55 万元/年, 累计效益达成率是 $11,293 / (9,855.55 * 2.25) = 50.93%$ 。未达到预计效益的原因是: 受中美贸易摩擦等宏观经济形势影响, 终端客户对市场预期不明朗, 备货谨慎, 2018 年下半年市场需求明显下滑; 另外全球半导体行业的技术发展具有周期性, 而带来的市场呈周期性波动下行影响, 该募投项目未完成预计效益。

公司法定代表人: 石明达

主管会计工作的公司负责人: 朱红超

公司会计机构负责人: 张荣辉